

WAR NR. E89-52650-342

PASSEND ZU

CAD-ORIGINAL

ZEICHNUNG NICHT ÄNDERN

VERWENDET FÜR

NUMMER 966 851

4

NICHT VERMASSTE KANTEN
SIND NICHT MASSTÄBLICH

NOT MEASURED EDGES ARE
NOT SCALED

ÄNDERUNGEN DIE DEM TECHN. FORTSCHRITT
DIENEN , BEHALTEN WIR UNS VOR

ALTERATIONS CONCERNING TECHN.
IMPROVEMENTS ARE RESTRICTED BY AMP

ZEICHNUNG GÜLTIG AB

DRAWING VALID FROM

15/00

ZEICHNUNG GESCHÜTZT DURCH
© COPYRIGHT 1995
AMP DEUTSCHLAND GMBH
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

6

0.3 ± 0.1

0.1 - 0.1

4

2

3

1

5

5.88 ± 0.1

1.2

7

KOAX STECKVERBINDER NACH CECC 22220
COAX CONNECTOR COMPLIES WITH SPEC. CECC 22220

8

VERGOLDET 0.1-0.2µm DICKE ÜBER
NOM. 4.0µm Ni P DICKE
0.1-0.2µm Au OVER NOM.
4.0µm Ni P PLATING

9

SMD-GURTVERPACKUNG NACH IEC 60286-3
SMD-STRIP-PACKAGING ACCORDING TO IEC 60286-3

10

EIN KUPPLER IN PLASTIKBEUTEL VERPACKT
ONE JACK PACKED IN PLATIC BAG

11

VERGOLDET NACH AMP SPEZ. 112-162-5; 0.8µm
MIN. DICKE ÜBER VERNICKELUNG NACH AMP SPEZ.
112-25-2; 2.0µm MIN.-4.0µm MAX. DICKE.
GOLD-PL. PER AMP SPEC. 112-162-5; 0.8µm
MIN. THK. OVER Ni-PL. PER AMP SPEC.
112-25-2; 2.0µm MIN.-4.0µm MAX. THK.

RECOMMENDED PCB: MATERIAL: FR4
THICKNESS 1.6 mm
DIELECTRIC CONSTANT = 4.8
PLATING: 30µm-70µm Cu

2

REV.

ÄNDERUNG

DATUM

NAME

0

NEUE ZEICHNUNG

29.11.95

M.STEIN

A

BLATT 2 VON 2 NEU HINZU

18.03.96

M.STEIN

B

PN 966 851-2 NEU HINZU

26.06.96

M.STEIN

B1

NEW PCB LAYOUT

05.02.97

B. RITHENER

C

NEW -3, -4

19.06.97

S. KEMPTER

D

ADAPTATION TO PACKAGING NORM

14.04.00

B. RITHENER

E

REV PER 0S14-0487-02

02.05.03

K. WEIDNER

E1

REV PER ECO 07-011908

10.10.07

J.LIPPERT

DIM "A"

1.74: PCB MIT MASSE VERBINDUNG AUF DER UNTERSEITE
2.07: PCB OHNE MASSE AUF DER UNTERSEITE
1.74: PCB WITH VIA CONNECTION AND GROUND ON THE OTHER SIDE
2.07: PCB WITHOUT GROUND ON THE OTHER SIDE

PCB LAYOUT

4.68

R0.9

R0.6

min 11

4.68

2.54

"A"

2.34

min 5.5

MASSTAB (5:1)
SCALE (5:1)

1	1	1	1	4	KUPPLERKÖRPER SHELL	CuZn	8
			-	3	BUCHSENKONTAKT FEMALE CONTACT	Phosphorbronze	11
			1	2	BUCHSENKONTAKT FEMALE CONTACT	Phosphorbronze	8
			1	1	ISOLIERSTÜTZE DIELECTRIC	PTFE	
966851-4	966851-3	966851-2	966851-1	ITEM NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	PLATING
				GEZ.	29.11.95	GEPR.	29.11.95
					M. STEIN		D.BOZZER

AMP

DSM AN AMP COMPANY
St MAURICE, SWITZERLAND

BENENNUNG/DESCRIPTION

COAXICON®SERIE MCX,SMD KUPPLER
FÜR LEITERPLATTENMONTAGE
(RASTER 5,08 mm)

COAXICON®SERIES MCX,
SMD JACK FOR PCB
(PITCH 5,08 mm)

NICHT TOLERIERTE MASSE

± 0.5
± -

FORMAT

A3

ZEICHNUNGS-NR.

966851

MASSTAB/SCALE

10:1

BLATT/SHEET

1 VON 2

REV.

E1

C

A

NICHT VERMASSTE KANTEN
SIND NICHT MAßSTÄBLICH

ÄNDERUNGEN DIE DEM TECH-
NISCHEN FORTSCHRITT DIENEN,
BEHALTEN WIR UNS VOR

ZEICHNUNG GESCHÜTZT DURCH
©COPYRIGHT 1996
AMP DEUTSCHLAND GMBH
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

966851

NUMMER

VERWENDET FÜR

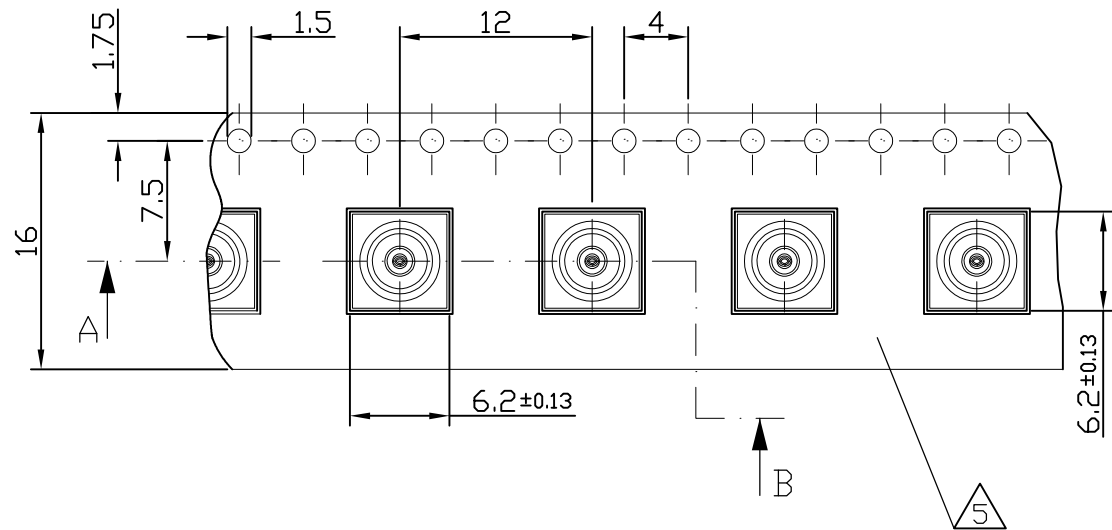
PASSEND ZU

CAD-ORIGINAL
ZEICHNUNG NICHT ÄNDERN

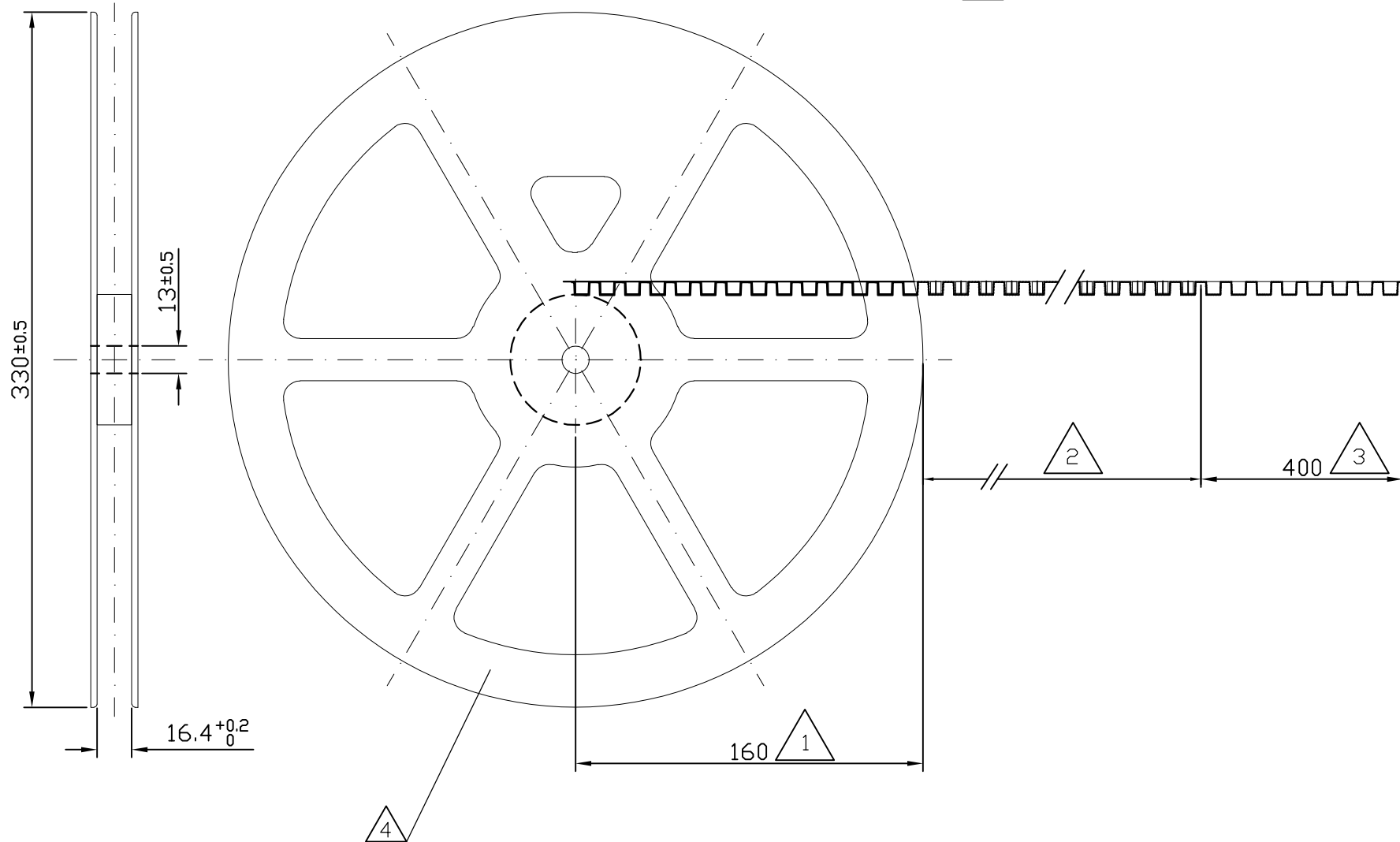
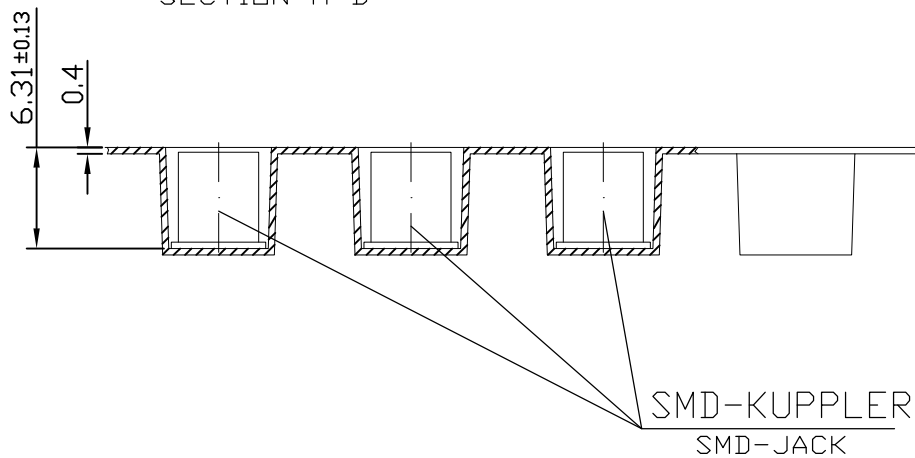
LOC
FK
DIST

WAR NR.

M3:1



SCHNITT A-B
SECTION A-B M3:1



6 EINHEIT PRO REEL: 800 STK.
UNIT PER REEL: 800 PIECES

5 BLISTERGURT NACH IEC 60286-3
BLISTER BELT ACCORDING TO IEC 60286-3

4 AUS POLYSTYREN
MADE FROM POLYSTYRENE

3 VORLAUF: MIN.400mm TRÄGERGURT NACH
IEC 60286-3
(LEER, ABER MIT ABDECKBAND VERSIEGELT)
OFFSET: MIN.400mm BLISTER BELT ACCORDING TO
IEC 60286-3 (EMPTY, BUT SEALED WITH
COVERBELT)

2 BLISTERGURT BESTÜCKT MIT BAUTEILEN
BLISTER BELT FILLED WITH PARTS

1 NACHLAUF NACH IEC 60286-3
(LEER ABER MIT ABDECKBAND VERSIEGELT)
LAST RUNNINGS ACCORDING TO IEC 60286-3
(EMPTY, BUT SEALED WITH COVERBELT)

ZEICHNUNG GÜLTIG AB 15/00					
AMP DSM AN AMP COMPANY ST MAURICE, SWITZERLAND					
BENENNUNG COAXICON®SERIE MCX,SMD KUPPLER FÜR LEITERPLATTEN- MONTAGE (RASTER 5.08 mm) COAXICON®SERIES MCX, SMD JACK FOR PCB (PITCH 5.08 mm)					
BESTELL-NR.		POS.	STÜCK	BENENNUNG EINZELTEIL	WERKSTOFF
GEZ.		29.11.95		GEPR.	29.11.95
M. STEIN		D.Bozzer		OBERFLÄCHE FARBE	
NACHSTAB		-		FORMAT	ZEICHNUNGS-NR.
-		-		A2	966851
BLATT		2 VON 2		REV. E1	

C